

2024 年臺德半導體晶片設計學術合作研究計畫(試辦方案) NSTC-BMBF Joint Research Program on Advanced Chip Designs 申請須知

2023/07/12

國科會(NSTC)鼓勵國內學者與德國學者在半導體領域之學術合作，培養晶片設計軟硬體系統整合的能力，促進學生國際交流，以培養具國際視野的人才；並落實臺灣與德國於 2023 年 3 月 21 日所簽署科學及技術合作協議。由國科會與德國聯邦教育及研究部(The German Ministry of Education and Research, BMBF)共同公開徵求 2024-2027 年臺德(NSTC-BMBF)半導體晶片設計學術合作研究計畫(Joint Research Program on Advanced Chip Designs)。

本項徵件案之重點說明如下：

一、計畫主持人及共同主持人資格與限制：

- (一) 臺方：須符合本會專題研究計畫(共同)主持人資格，每一計畫主持人對本項徵件案僅限研提 1 件計畫。
- (二) 德方：計畫主持人須符合德方(BMBF)計畫主持人資格。

二、合作領域：

- (一) Edge-AI Chip Design (智慧終端晶片設計)
- (二) Chips for Emerging Application and Automotive Solution (先進晶片應用及自駕解決晶片方案)

三、補助計畫類型：

雙邊協議專案型國際合作研究計畫(Joint Call)，雙方組成合作研究團隊，共同合作進行本項研究計畫，任一方未收到申請書，合作案無法成立。

四、計畫期程：

- (一) 獲雙邊選定通過之計畫自 2024 年 5 月 1 日起開始執行，與德方共同研究計畫之執行期間相同。
- (二) 計畫期程最短 1 年，最多不得超過 3 年。

五、補助經費：

- (一) 經臺德雙方共同討論後選定補助計畫，並分別予以補助。
- (二) 計畫補助額度：本專案將擇優補助選定之計畫，每年每件以不超過新臺幣 200 萬元為原則。

- (三) 臺德雙方各自負擔合作計畫所需之研究經費，包括業務費（含研究人力費及物品耗材費）、研究設備費、國外差旅費及管理費等。
- (四) 與研究計畫相關之小型研討會、互訪以及鼓勵學者或學生至德國異地研究，所需經費得於計畫內提出。
- (五) 臺方計畫主持人於計畫執行期間僅得支領 1 份研究主持費，同一執行期限若同時執行 2 件以上，以最高額度計算。

六、計畫收件及審查時程：

- (一) 本項徵件為半導體領域合作計畫，分為「計畫構想書」及「完整計畫書」兩階段進行。獲第一階段推薦者，方可進入第二階段提送完整計畫書。
- (二) **計畫構想書受理截止日：2023 年 9 月 5 日(週二)止**，申請機構須於截止期限前由本會專題計畫系統彙整送出，並依第七點(二)之規定函送本會。
- (三) 計畫構想書階段，經本會與德方(BMBF)雙方獨立審查後，再共同審議選定具潛力計畫後，始由本會與德方(BMBF)分別通知雙方計畫主持人提出完整計畫書(Full Proposal)。
- (四) **完整計畫書受理截止日期：2024 年 1 月 31 日(週三)止**，申請機構須於截止期限前由本會專題計畫系統彙整送出，並依第七點(二)之規定函送本會。
- (五) 公告核定日期：**2024 年 4 月底前**。若因不可抗力因素、協議機構審查時間或雙邊年會時程延後等，本會得視情形調整公布審查結果時間。

七、申請方式：

- (一) 本項徵件為半導體領域合作計畫，分為「計畫構想書」及「完整計畫書」兩階段進行，計畫申請方式均請依以下(二)之規定函送本會，惟完整計畫書須待本會通知計畫構想書審查通過者，始得進行提交。
- (二) 請依循本會專題研究計畫之申請程序，於線上系統填列計畫申請書。部份重點包括：
 1. 至本會網站(<https://www.nstc.gov.tw/>)首頁「學術研發服務網登入」處，身分選擇「研究人員(含學生)」，輸入計畫主持人之帳號(ID)及密碼 (Password)後進入。
 2. 在「學術研發服務網」之學術獎補助申辦及查詢內之【專題計畫】工作頁下第一項【專題研究計畫】點入後，選擇【雙邊協議專案型國際合作計畫(Joint Call)】進入個人基本資料畫面，若無修改，確定後即進入本系統之「主畫面」，從主畫面視窗上左上方點選新增，即可新增一筆。
 3. 「研究型別」請選【個別型計畫】，「計畫歸屬」請選【工程處】，學門代碼請選【E9876-臺德半導體合作計畫】。
 4. 中文計畫書名稱，於構想書階段請以【臺德半導體合作計畫構想書-】為首，續寫研究計畫名稱；完整計畫書階段請以【臺德半導體合作計畫-】為首，續寫研究計畫名稱。

5. 應填列一般專題研究計畫申請所需之各項 CM 表及工程處專屬表格，於構想書階段【CM03】表頁數至多 10 頁，於完整計畫書階段【CM03】表頁數至多 25 頁，中英文不限。
 6. 【CM01】申請表內【本計畫是否有另外申請國際合作研究】欄位應勾選【是】；除一般專題計畫申請所需之各項 CM 表及相關學術處規定文件，亦應填具【IM01】、【IM02】、【IM03】國際合作計畫表。
 7. 【IM01】表之「合作國家」請選「與單一國家合作」，「國別」請選填【334 德國】。「國外合作計畫經費來源」為本會雙/多邊協議機構，並勾選【德國聯邦教育及研究部(BMBF)】
 8. 【IM02】表屬國際合作研究計畫其他相關附件上傳功能鍵，請將本項申請案之(1)共用英文申請表：「NSTC-BMBF Joint Research Program on Advanced Chip Designs APPLICATION FORM」、(2)德方計畫主持人英文履歷及著作目錄等資料依序合併為單一 PDF 檔案後上傳至系統，未上傳者視為申請資料不全。本項資料請勿超出 10 頁(不包含德方計畫主持人英文履歷及著作目錄等資料)。
- (三) 計畫構想書及完整計畫書申請案須由主持人任職機構於系統中彙整後送出，依本會「專題計畫線上申請彙整」作業系統製作及列印申請名冊(由系統自動產生，並依計畫歸屬處別列印)一式二份，並依第六點(二)及(四)之規定時間內函送本會(以發文日期為準)。

八、注意事項：

- (一) 本項共同研究計畫須經本會與德方(BMBF) 雙方獨立審查後，再共同審議選定補助計畫，故不受理申覆。
- (二) 具以下情況之申請案恕不受理：
 1. 德方計畫主持人資格未符BMBF之規定；
 2. 德方計畫主持人未依BMBF規定提出計畫；
 3. 申請日期超過公告截止日期；
 4. 申請資料不全；
 5. 未依本會專題研究計畫作業要點規定及本申請須知所述方式提出。
- (三) 本案通過之計畫可不受本會一般專題計畫補助件數之限制，惟計畫主持人同年度執行此類「雙邊協議專案型國際合作計畫(Joint Call)」及「雙邊協議擴充加值(add-on)國際合作計畫」合計仍以 2 件為限。倘計畫主持人申請時已執行 2 件此類計畫(指計畫執行期限內與本次徵求案預定執行期間重疊達 3 個月以上)者，不得再提出本項計畫申請；若計畫於受理審查過程中，主持人另執行此類計畫達 2 件時，本會將不再核予此第 3 件。
- (四) 計畫核定後之經費撥付、報銷與報告繳交作業，均依本會補助專題研究計畫作業要點等相關規定辦理。
- (五) 雙方計畫主持人應於每年計畫執行期限結束前(後)提供期中(期末)報告，並據以評

估每項計畫之合作成效，評估結果將作為計畫繼續或終止補助、補助經費調整，以及計畫調整之依據。

(六) 雙方計畫主持人於規劃合作時，應先議定未來雙方智慧財產權與成果之歸屬、管理及運用方式，必要時可共同簽訂相關計畫合約書。

(七) 年度所需經費如未獲立法院審議通過或經部分刪減，本會得依審議結果調減補助經費，並按預算法第五十四條規定辦理。

九、承辦人聯繫資料：

臺方：

國科會 科教發展及國際合作處 胡秀娟研究員

電話：+886-2-2737-7560

Email: jenhu@nstc.gov.tw

德方：

For the German partners to be funded under this call, please contact BMBF directly.

Reference: <https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2023/06/2023-06-02-Bekanntmachung-Chipentwicklung.html>

Additional information can be obtained from the following contact persons:

Dr. Tina Tauchnitz, Dr. Korbinian Schreiber

VDI/VDE Innovation + Technik GmbH

Project Management Agency “Electronics and autonomous driving; supercomputing” on behalf of Federal Ministry of Education and Research, Germany (BMBF)

Steinplatz 1, 10623 Berlin, Germany

Tel.: +49 30 310078 3584

E-mail: Designinitiative-ME@vdivde-it.de